

ヨコオの価値創造プロセス

当社グループは、「6つの資本」を活用しながら、コアコンピタンス（微細精密加工／高周波／先端デバイス）を重層的に組み合わせることで、社会に価値を提供しています。これからも、4つの経営の基本方針を柱とした事業活動を通じて持続可能な社会の実現を目指し、当社らしい価値創造に努めていきます。



▼ マテリアリティ/KPI・2030年度目標

重点領域	マテリアリティ	考え方・選定理由	KPI (2030年度目標)		2023年度実績(「-」は新規KPI) [補足・参考]
			評価指標	目標値	
人的資本	多様性・公平性・包摂性	国籍・性別・世代等にとらわれず、多様な人材を採用・育成し、従業員一人ひとりが最大限に力を発揮できるよう、個性の尊重と公正・公平な処遇、働きやすい職場づくりに努めることを、多様性に関する基本方針としています。この基本方針に基づき多様性を拡大するとともに公平性と包摂性を高めることが、多様な人材がそれぞれの持つ能力を高い意欲を持って発揮することにつながり、当社グループの永続的進化を実現する基礎になると考えています。	TISP ^{※1} 採用・在籍者数	120名以上(累計)	75名
			障がい者雇用比率	3.45%(2023年度法定雇用率:2.3%の1.5倍)	2.3%
			女性管理職者比率	10%以上	全管理職者数に対する女性管理職者の割合 3.6%(2024年3月末現在)ヨコオ単体
			従業員のエンゲージメント向上	2022年スコア46 ^{※2} を基準とし、できるだけ早期に20%UP達成とその維持を目指す	- (2023年度は実施見送り)
	グローバル人材育成	グローバルに人材を有しているという当社グループの優位性を確固たる競争優位とするには、グローバル人材に対する教育を重点的に拡充していくことが必要不可欠であると考えています。	通信機器系：有資格者数	60名	- [2024年10月現在31名]
			コネクタ系：製品・工法の発明者数	72名	48名
			メディカル系：医療事業人材製造販売業者における三役 ^{※3} の力量保有者数とFDA、MDR対応者	20名	5名
			DXリテラシー標準の社員習得レベル ^{※4}	標準を超えた社員比率20%以上	- [2024年10月現在6%]
人権	人権尊重	国連「ビジネスと人権に関する指導原則」を支持し、これに基づき「ヨコオグループ人権方針」を策定し、人権尊重と救済に取り組んでいます。人権方針で定めるステークホルダーとの対話を重視し、サプライチェーン全体を通じた人権への負の影響を特定・評価し、具体的な課題への取り組みを推進しています。	グループ全拠点における人権研修受講率	100%	89%ヨコオ単体
			ヨコオグループ全拠点における人権デュー・デリジエンスのリスク評価	(ヨコオ独自の指標) B以上	(生産拠点14社) A:0社、B:4社、C:7社、D:3社、E:0社
	私たちと働く人の権利	人権における具体的な課題は、公正・公平を第一に取り組み、サプライチェーン全体で働く人の権利を尊重します。より安全・安心で、働きがいのある職場環境づくりへの取り組みを推進していきます。	ヨコオグループ主要取引先(総仕入高上位80%)に対するデュー・デリジエンス実施率	100%	- [2024年9月末現在97%(29/30社)ヨコオ単体]
			休業度数率	基準年度(2023年度)の休業度数率から30%改善した0.23	0.329
ステークホルダーエンゲージメント	顧客満足	お客さまから「ヨコオと取引していて良かった。もっと拡大しよう」と言っていたる会社を目指しています。お客さまの期待に応えるため、お客さまの声を真摯に受け止め、誠実に取り組んでいきます。これらを継続することにより「ヨコオ品質ブランド」を確立し、お客さまとの長期的な信頼関係を構築していきます。	顧客満足度調査のスコア	基準年(2023年度)のスコア以上を毎年度維持する	VCCS:83.9、CTC:82.3、FC:87.5、MD:68
	取引先との双方向コミュニケーション	お取引先から「ヨコオの仕事をしていて良かった。もっと貢献できるよう頑張ろう」と言っていたる会社を目指しており、そのために公正・公平な取引を追求しています。相互に価値を高め合うパートナーシップを築き、長期的な信頼関係を構築していきます。	仕入先説明会やCSR調達水準向上に向けたサステナビリティ説明会の実施	年1回以上	開催なし
	地域社会との対話・交流	地域社会の皆さまから「ヨコオがこの町にいて良かった。是非うちの子供をヨコオに入社させたい」と言っていたる会社を目指しており、そのためには地域の発展や社会が抱える課題について対話と交流が重要だと考えています。当社グループの事業や社会課題の解決に寄与する取り組みを理解いただきながら、信頼関係を築くことに努めています。	社会貢献活動	70件/年	35件
	株主・投資家との対話	株主さま・投資家さまとの長期的な信頼関係を構築するため、正確・迅速かつ積極的な情報開示に努めています。また、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るべく、株主さま・投資家さまとの建設的な対話に積極的に取り組んでいます。	決算説明会、スモールミーティング等の実施	5回/年	決算説明会 2回
			個別IR(国内・海外合計)	200件/年	個別IR 140件
	地球環境	気候変動の緩和と適応	カーボンニュートラルの実現に向けて、環境方針および行動指針に基づき、気候変動への対応を強力に推進するとともに、事業活動を通じた社会の発展に貢献していきます。	GHG排出量削減 2014年度比	35%削減
循環型社会への移行と、有害物質の管理・削減		地球環境および人体に影響を与える物質や、廃棄物のリサイクルを阻害する物質の使用量削減をグループ全体で推進しています。環境関連法規、条例等の要求事項および顧客要求事項を遵守し、有害物質の管理と削減を通して、地球環境保全と循環型社会の実現に貢献していきます。	水使用量(原単位)2020年度比	10%削減	2020年度比16.4%
			再生プラスチック使用率	25%以上	-
			廃棄物のリサイクル率	グローバル80%以上	グローバル74%
PRTR対象物質使用量削減(国内グループ)	代替物質の積極的な検討による、PRTR対象物質の使用量抑制	12,440kg			
ガバナンス	コーポレート・ガバナンス	コーポレート・ガバナンスの強化が経営の重要課題の一つであると位置付け、経営の効率性、透明性および遵法性を確保し、経営目標の達成を目指します。	取締役会の実効性評価	5段階評価で4.5以上	- [2024年5月実績:4.27(自己評価アンケートによる)]
	コンプライアンス	常に企業価値の向上を目指し、ステークホルダーの信頼に応えるため、経済・環境・社会に影響を与える活動に対し、透明かつ高い倫理観を持って取り組むことで、持続可能な社会の発展に貢献します。	ボードダイバーシティ	取締役会の実効性および企業価値の向上に資する取締役会構成の最適化 ^{※5}	-
			コンプライアンス研修受講率(ヨコオグループ全拠点)	100%	- [2023年度3回ヨコオ単体]
	リスクマネジメント	事業活動におけるリスクの影響に配慮し、関連法令および規程を遵守するとともに、リスクマネジメントシステムおよびパフォーマンスの継続的向上への取り組みを通じて、リスクに適正に対応することにより企業の社会的責任を果たし、組織運営の安定化に努めます。	内部通報制度の認知度(ヨコオグループ全拠点)	100%	- [2024年7月調査時45.3%]
			リスクアセスメントに基づく重要リスクの特定と施策実施の進捗確認	年1回以上	1回
社内セキュリティインシデント重要度判断に基づくインシデント件数	40以上を0件 ^{※6}	-			

※1 TISP: Tomioka International Specialist Park
 ※2 クアルトリクス社によるエンゲージメント調査のスコア

※3 三役: 総括製造販売責任者、国内品質業務運営責任者、安全管理責任者

※4 全社員が具備すべきDXスキルとして経済産業省が定めているDXリテラシー標準を習得している社員の比率をKPIとする。

※5 女性/外国籍/独立性を中心に最適化を毎年度検討
 ※6 ヨコオ独自の指標である重要度が高いインシデントのゼロ化・維持を目指す。

ヨコオのものづくり

当社グループは、微細精密加工技術／アンテナ技術／マイクロウェーブ技術などのコア技術を深掘りしながら最先端の技術を積極的に取り込み、世界のリーディングカンパニーへ多彩な独創的製品を提供しています。また、高水準のQCDSを実現するため、日々生産プロセスの革新を推進するとともに、モノからコトへの事業モデル進化を実現すべく、ソフトウェア開発力の強化にも取り組んでいます。

最先端の研究開発

基礎研究

マイクロウェーブ技術

自動運転・5Gが進展する中、車載通信・半導体分野におけるマイクロウェーブ技術の重要性がますます高まっています。当社は無線通信・半導体回路検査の両面から世界最高水準のマイクロウェーブ技術の確立を進めています。

プロセス開発

微細精密加工

世界最高水準の微細精密加工技術に加え、精密めっき、MEMSプロセスの競争力強化を進めています。

生産プロセス

主要な要素技術は全て当社生産技術部門が開発しており、生産・品質管理へのAI適用も進めています。

設計プロセス

3次元CAD情報を活用した設計からメンテナンスまでの一貫システムの確立を進めています。

製品化研究

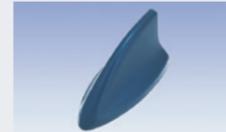
研究開発部門・プロセス技術部門および新製品開発・事業化を担う部門が密接に連携する体制を整えています。また、他社や大学などとも連携して先端技術を取り入れ、製品進化と事業重層化を推進しています。

応用研究

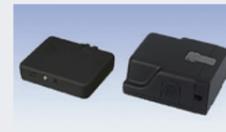
- 無線技術・ソフトウェア開発力を活用した社会プラットフォーム構築に関わるシステム提案
- 自動運転・5Gの進化に不可欠な半導体デバイスに組み込まれた無線アンテナ機能自動検査技術と高速光通信デバイス・コネクタの開発
- ターンキー型半導体検査用治具システム提案

重層化が進む製品

車載アンテナ製品群



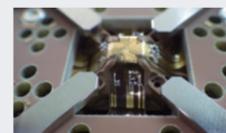
ソフトウェア応用製品群



半導体検査製品群



高周波デバイス検査製品群



電子機器用コネクタ製品群



医療用機器製品群



製品を展開する分野

拡大・強化分野



車載アンテナ
● 自動運転



半導体検査用治具
● 5G/6G ● ターンキー



電子機器用コネクタ
● 小型/低背/防水/大電流



医療用機器
● 精密部品 ● アッセンブリ品

戦略的育成分野



社会プラットフォーム
● シェアカー ● ドローン



高周波デバイス検査
● アンブ ● フィルター



AI半導体
● 光電融合 ● 光電変換



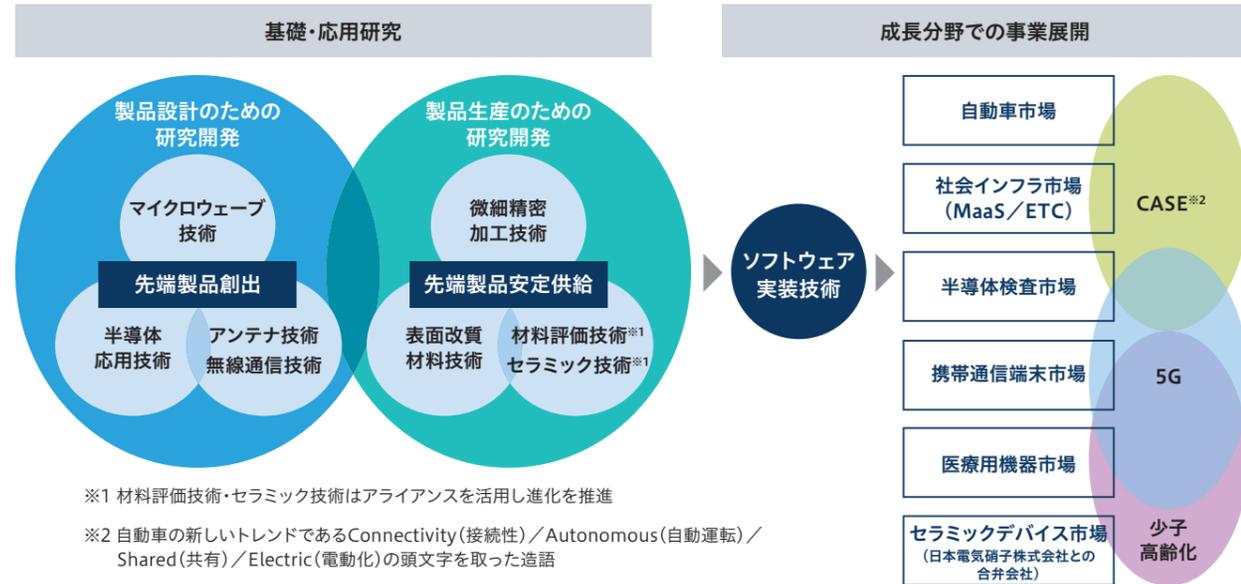
精密めっき
● 湿式 ● 乾式

世界一の高周波・無線応用・精密部品メーカーへ

研究開発

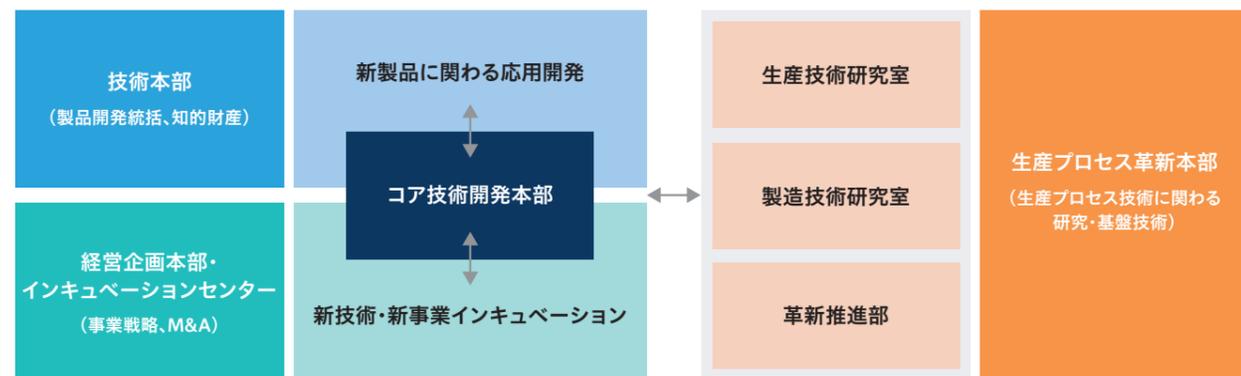
当社グループは、微細精密加工技術／マイクロウェーブ技術／アンテナ技術／表面改質材料技術（表面処理・材料改質）／半導体応用技術の5分野を、事業競争力を支えるコア技術と定めています。各技術の深化と複合化により事業の重層化を進め、先端製品を創出していきます。

研究開発方針



研究開発においては、「製品設計のための研究開発」と「製品生産のための研究開発」を車の両輪と位置付けています。両者をシンクロナイズさせることで先端製品の創出と、お客さまへの安定供給を実現しています。

研究開発体制

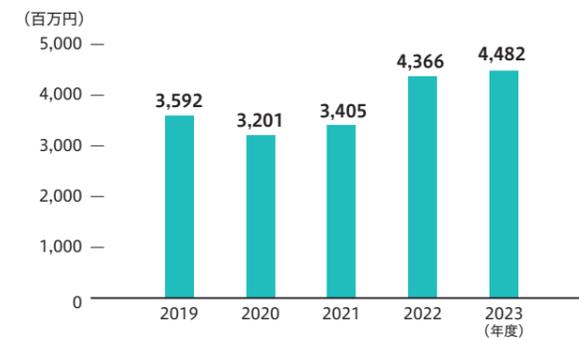


新製品に関わる応用開発は事業部・技術部ごとに実施し、製品開発全体と先端技術開発を技術本部が統括しています。新技術・新事業のインキュベーションは経営企画本部・インキュベーションセンターが担当し、研究開発のうち、マイクロウェーブ技術、微細精密加工技術、MEMS技術など当社製品の競争優位に必要な技術はコア技術開発本部が担当しています。また、製品生産に関わる研究は生産プロセス革新本部が担当しています。

研究開発投資

当社グループでは、「全社成長戦略」に基づき、コア技術を核に、研究開発部門、事業部技術部門および現地開発拠点が丸となって研究開発を推進しています。特に技術集積度がより高く付加価値の高い製品展開に重点を置き、新技術および新製品の研究開発に注力しています。

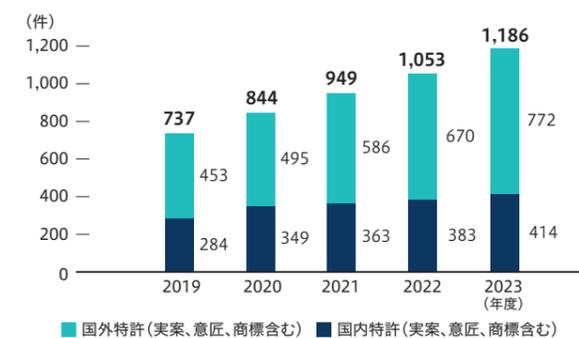
▼ 研究開発費推移



知的財産権

知的財産について注力する事業分野や事業展開を見据え、国内外の保有特許を確実に増やし、ライセンスなども積極的に活用することで、事業戦略の要である知的財産の基盤を強化しています。

▼ 特許保有件数推移



主要な研究開発テーマ

中長期的に、CASE(Connectivity/Autonomous/Shared/Electric)と呼ばれる次世代技術への投資集中やCASEの進展に伴い、ハードウェアである車両と複数の交通手段の決済の統合等のソフトウェアサービスを組み合わせたMaaS (Mobility as a Service: サービスとしての移動)と呼ばれるビジネスモデルの拡大、5GおよびBeyond 5G (6G)に代表される次世代高速・大容量通信用など新規半導体需要の顕在化、ウェアラブル端末など次世代製品の普及、低侵襲医療の浸透や遺伝子検査技術の高度化により、市場の拡大が予想されます。

上記市場に関わる各セグメントの主要な研究開発テーマは以下の通りです。

VCCS

- ADAS・自動運転に不可欠なV2X (車/車間、道路/車間、歩行者/車間)用アンテナシステム
- CASE時代に向けた通信システム・機器・デバイスの技術開発

CTC

- 大電流および高速高周波デバイスに対応した検査用ソケットの開発
- プローブの表面改質など、高機能・高耐久・機能向上を目標とする研究開発
- 半導体デバイスのロードマップ (狭ピッチ・多ピン・高周波) に歩調を合わせるプローブカードの開発

FC・MD

【FC (ファインコネクタ) 事業】

- 宇宙や海洋を含む、スマート社会実現へ向けた小型ロボットや通信機器向けの製品開発
- 小型・軽量に特化した“世界最小スプリングコネクタ”の開発

【MD (メディカル・デバイス) 事業】

- 微細精密加工技術およびマイクロウェーブ技術を応用した日米の大学・医療機関と新たな低侵襲の医療用機器や検査システムの共同開発

インキュベーションセンター

- パートナー企業と新たな市場を創造する製品・ソリューションの開発
- モノ売りからコト売りへ、サブスクリプションなどの新たなビジネスモデルの創出

製品技術

当社グループは、長年にわたり蓄積してきた独自の技術力を基盤に、革新的かつ多彩な製品を開発し、世界の電子・電機・自動車メーカーなどに提供しています。

独自技術の融合による独創的製品開発



コア技術である微細精密加工技術／マイクロウェーブ技術／アンテナ技術／表面改質材料技術、そして、より効率的に製品を生産するための「製造プロセス開発技術」を融合することで、独創的な製品開発を実現しています。また、技術力の深化・蓄積を進めるとともに新たなコア技術の基礎研究開発も推進しています。

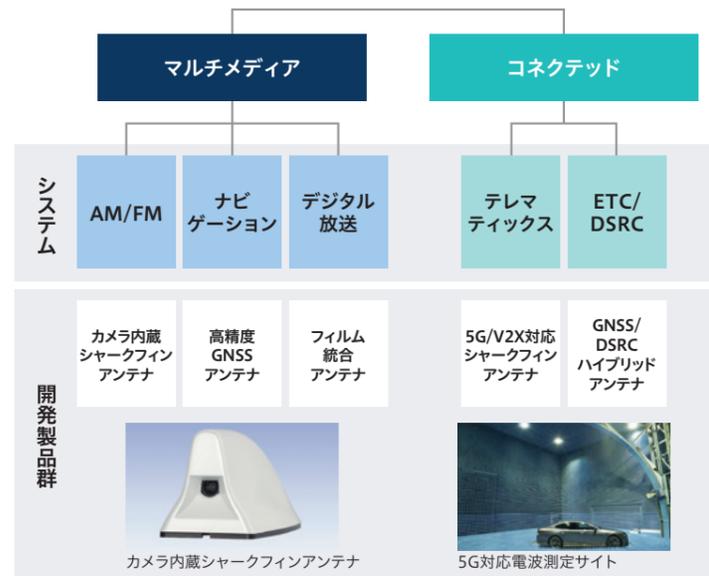
こうした独自の技術により車載アンテナ、半導体・電子部品検査用治具、電子機器用コネクタ、医療用デバイスなど革新的かつ多彩な製品を製造し、「自動車／MaaS市場」「半導体検査市場」「携帯通信端末市場」「医療用機器市場」へ提供し続けています。

自動車／MaaS市場

車載アンテナに求められる小型化・複合化・低背化・スマート化といったニーズに応えるため、長年培ったアンテナ技術・マイクロウェーブ技術に加え、モジュール化技術を駆使し、次世代の車載通信を支えるアンテナシステムを開発しています。

また、電磁界シミュレーターや5G通信におけるミリ波周波数（～40GHz）の測定に対応した電波測定サイトなどの最新鋭設備を取りそろえるとともに、世界最高水準の技術力を駆使して、業界をリードする革新的な製品を製造しています。

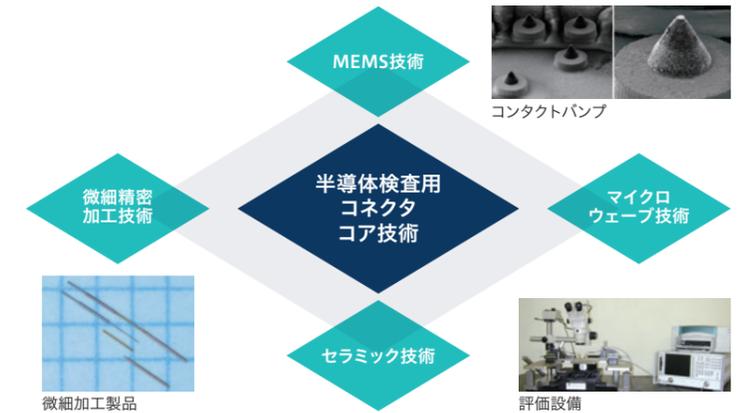
▼ VCCSセグメント展開領域



半導体検査市場

半導体や電子部品は、これまで以上の高速化・高周波化・高集積化が求められ、検査プロセスにおいても同様の対応が求められています。当社は、長年培った微細精密加工技術とマイクロウェーブ技術に加え、MEMS技術を駆使することで、高速・高周波および前工程・後工程検査プロセスの全ての領域における製品をグローバルに開発・提供しています。

▼ CTCセグメント展開領域



携帯通信端末市場

急速に拡大する携帯通信端末市場において、コネクタは着脱性・低背省スペース化のニーズが高まり、業務用情報端末機器においては着脱耐久性・耐環境性がより一層重要になってきています。当社が独自に開発したスプリングコネクタは、こうした市場ニーズを的確に捉え、さまざまな用途に使用され急速に普及が進んでいます。

▼ スプリングコネクタの特長と主な用途



医療用機器市場

微細精密加工、コーティング、アッセンブリ（組み立て）、製品設計・評価などの技術を駆使し、低侵襲医療分野のOEMガイドワイヤ／カテーテルなどの製品を開発しています。設備・製造ラインも当社内に完備し、製品加工から完成品組み立て、親水性コーティング、梱包・滅菌まで、一貫したサービスを提供します。アッセンブリ工程においては、用途に応じてさまざまな接合方法を選択可能です。

